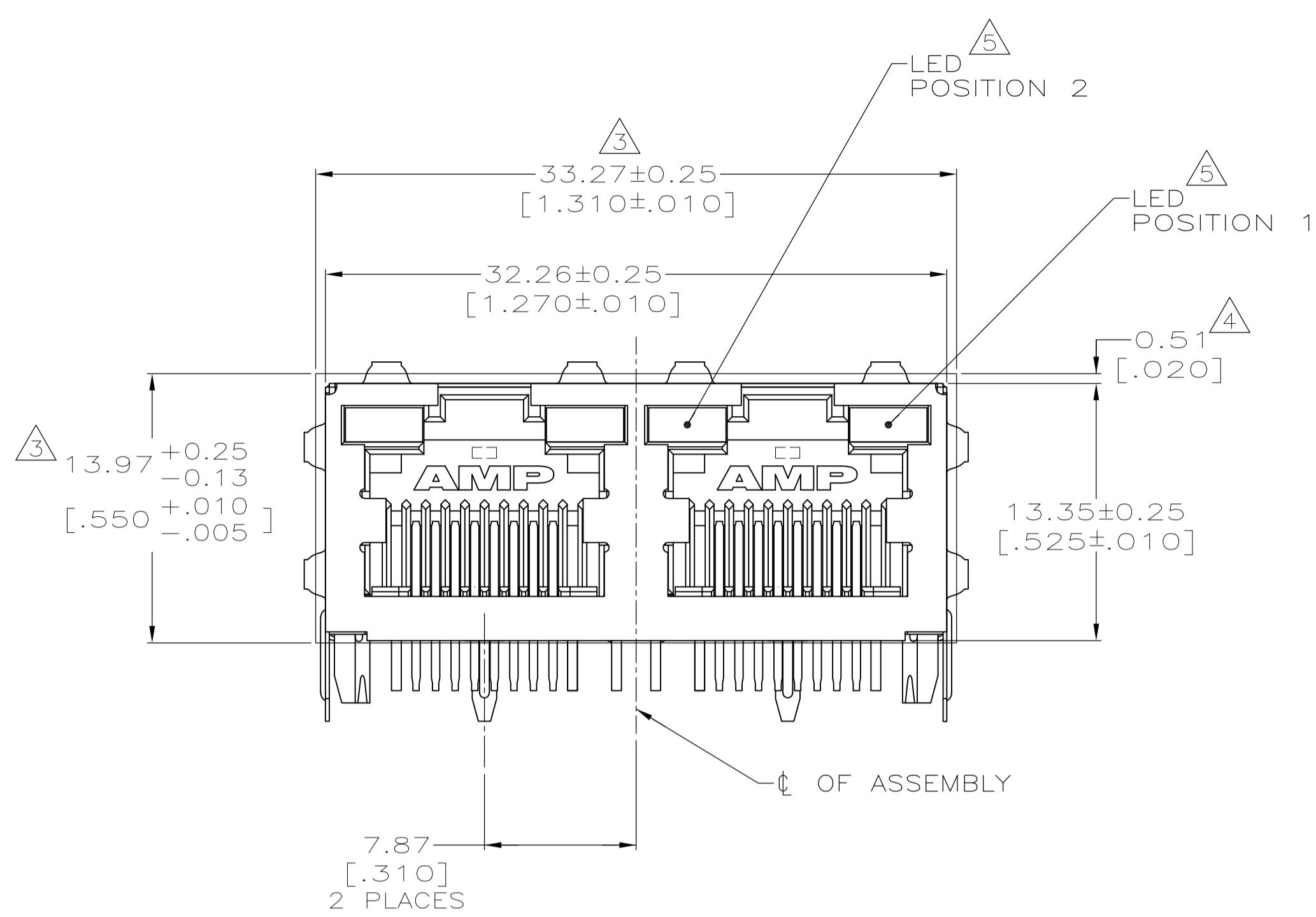
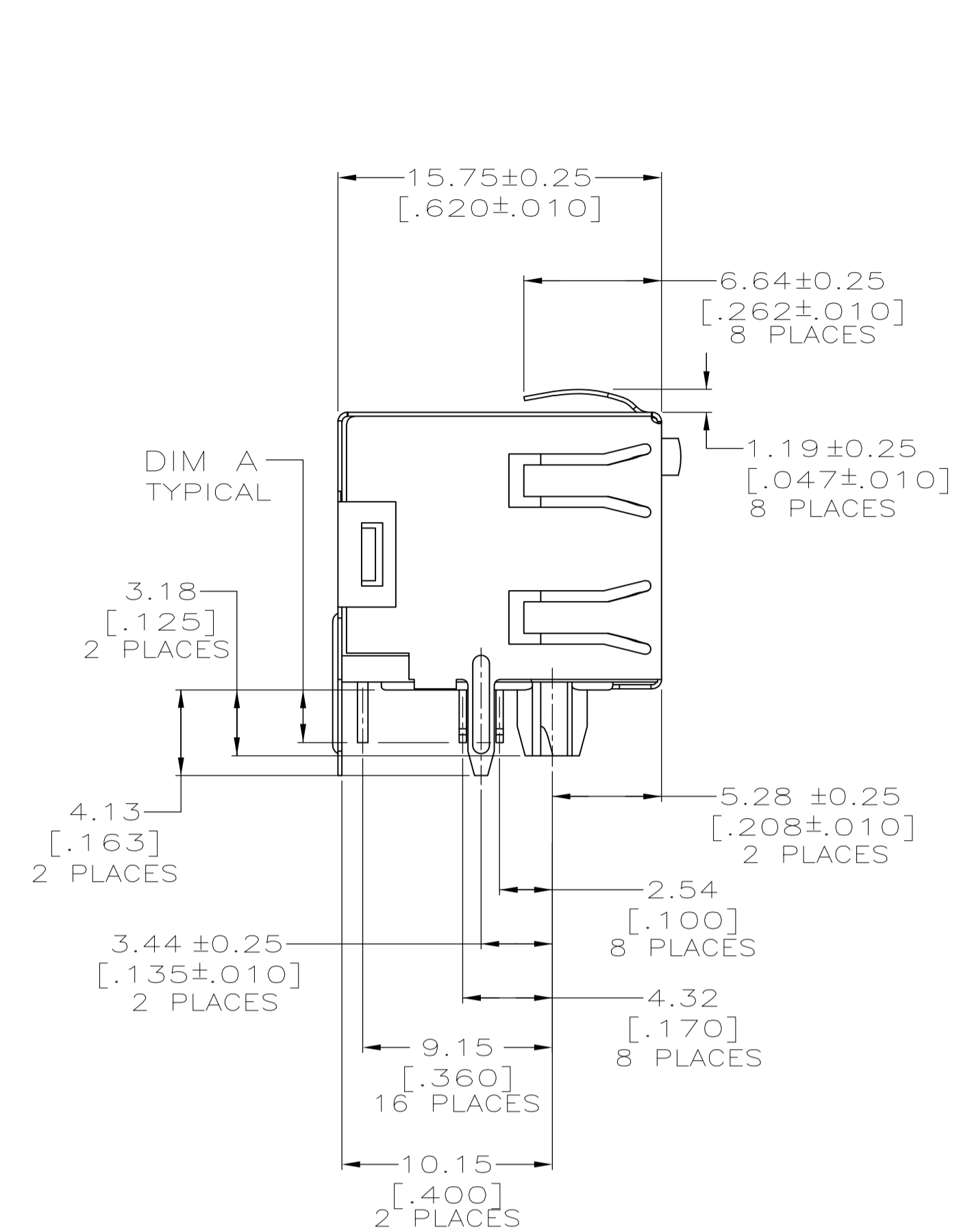
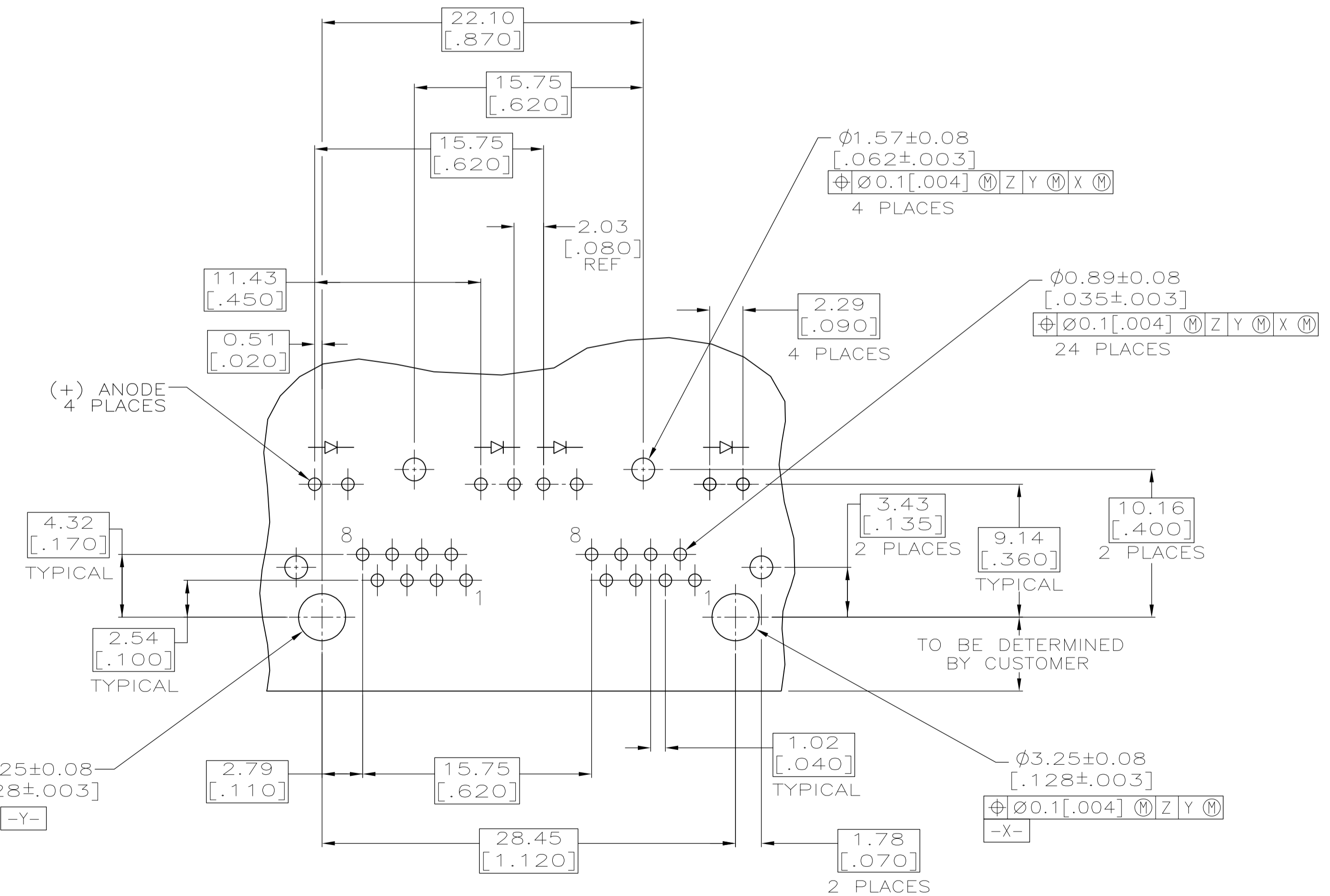
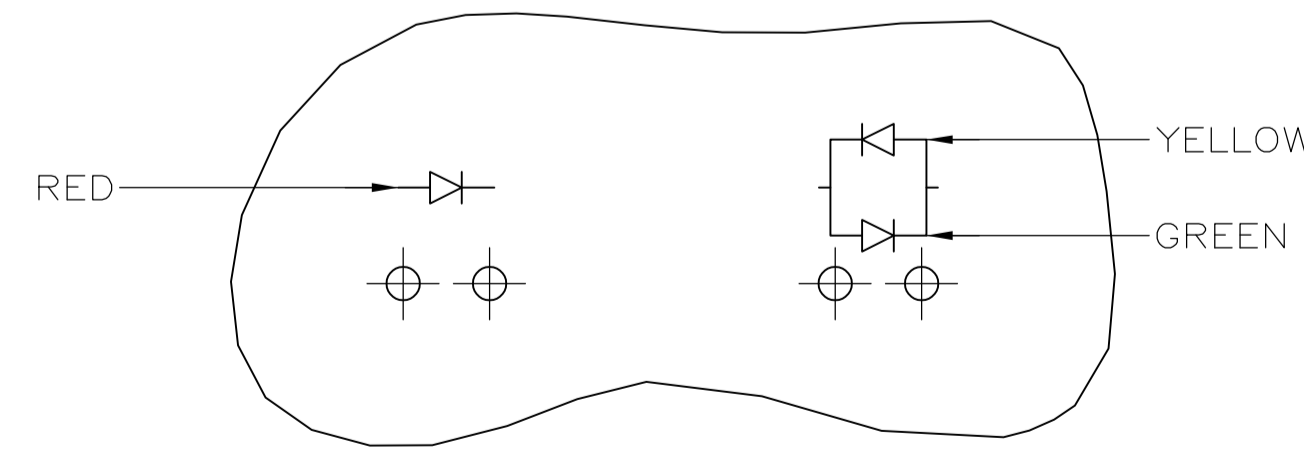
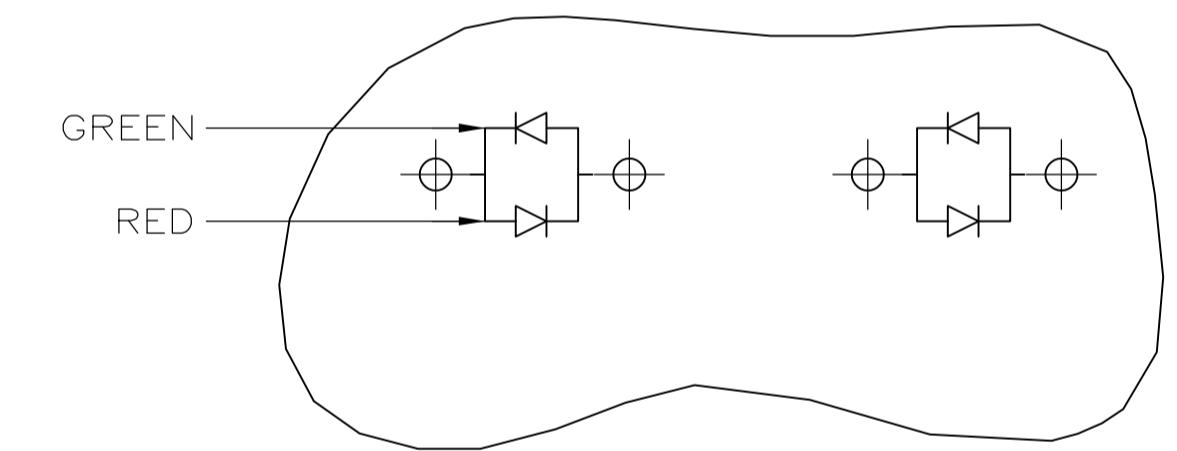
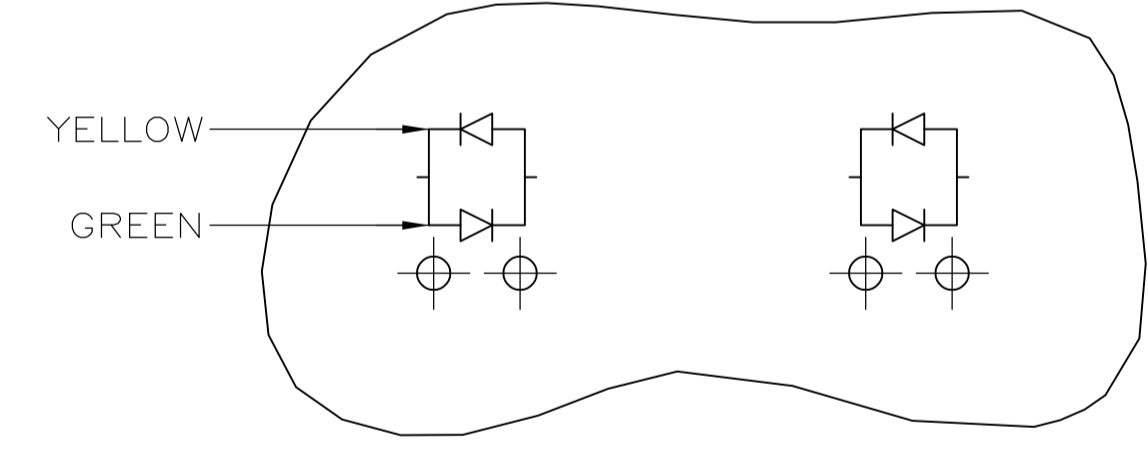
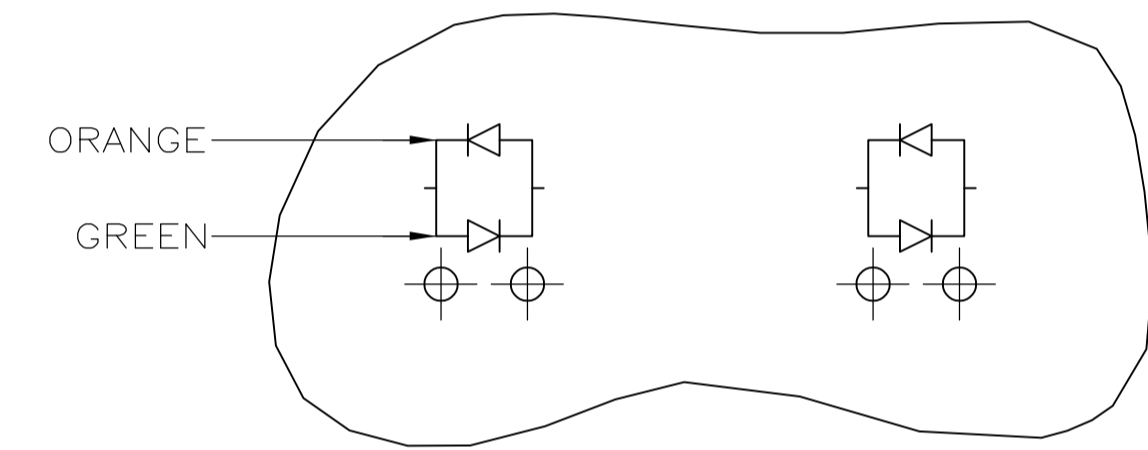


LOC		DIST		REVISIONS			
AA	00	F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DMN	APVD
E	REV PER ECO-13-000217				31DEC2012	DZ	AC



- MATERIAL:
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
TERMINALS - 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27µm [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm [.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MINIMUM TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
LIGHT EMITTING DIODE (LED) - DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89µm THICK Sn/Cu OVER 2.03µm THICK Ag OVER 1.02µm THICK Cu OVER 3.56µm THICK Ni OVER 1.02µm THICK Cu UNDERPLATE
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
- SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
- SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.
- THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.
- OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- TAPE & REEL PACKAGING, FULLY ESD COMPLIANCE.



SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT (COMPONENT SIDE)

INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING	POSITION 2	POSITION 1	PART NUMBER
2.54 [.100]	YELLOW	GREEN	3-6116353-2
3.05 [.120]	YELLOW	GREEN	3-6116353-1
3.55 [.140]	RED/GREEN	RED/GREEN	2-6116353-9
3.05 [.120]	YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	2-6116353-8
3.05 [.120]	GREEN	GREEN	2-6116353-4
2.54 [.100]	RED	YELLOW/GREEN	2-6116353-3
2.54 [.100]	RED/GREEN	RED/GREEN	1-6116353-3
3.55 [.140]	YELLOW	GREEN	6116353-9
2.54 [.100]	YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	6116353-8
2.54 [.100]	ORANGE/GREEN	ORANGE/GREEN	6116353-7
2.54 [.100]	YELLOW	YELLOW	6116353-6
2.54 [.100]	GREEN	GREEN	6116353-5
2.54 [.100]	GREEN	YELLOW	6116353-4
2.54 [.100]	YELLOW	-	6116353-3
2.54 [.100]	-	GREEN	6116353-2
2.54 [.100]	YELLOW	GREEN	6116353-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN DL DRUMMOND/L.A.MAYER		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S.FLICKINGER	
0 PLC	± -	1 PLC	± 0.25[.01]	NAME INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X2, SHIELDED, PANEL GROUND, WITH LEDS	
2 PLC	± -	3 PLC	± 0.13[.005]	APPLICATION SPEC 108-1163-4	
4 PLC	± -	ANGLES	± -	SIZE 114-2154	
MATERIAL SEE NOTE 1	FINISH SEE NOTE 1	WEIGHT	-	SCALE A1	00779 6116353
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1	SHEET 1 of 1	REV E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9